



本社：〒160-8366  
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号  
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20120917005  
2012 年 9 月 20 日

## お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社  
営業・技術本部 カスタマドキュメント  
マネージャ 牧 達郎 

### HPA T03 Metal Can パッケージ 一部製品 部材変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけただけのものとして判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは [pcn\\_tij@list.ti.com](mailto:pcn_tij@list.ti.com) にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input checked="" type="checkbox"/> Process	<input checked="" type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling		<input type="checkbox"/> -
変更内容	HPA T03 Metal Can パッケージ 一部製品 部材変更 現行 : Substrate, Solder Flux, Solder Paste 部材変更未対応 変更後 : Substrate, Solder Flux, Solder Paste 部材変更対応			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2013年1月上旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し		<input type="checkbox"/> 変更あり	
備考	—			

変更内容

内容：弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) T03 Metal Canパッケージ 一部製品について、Solder Flux/Paste供給業者製造終了及びSolder Attach Void低減の為に、Substrate, Solder Flux, Solder Pasteを変更します。部材変更は下表を参照下さい。組立サイトの変更はありません。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
Substrate, Solder Flux, Solder Paste部材	変更未対応	変更対応

製品名	部材	現行	変更後 (Snowflake Pattern)
OPA541	Substrate	MC01569-CMMT/A	MC01569-CMMT/A4
	Solder Flux	039090010	039090009
	Solder Paste	6036001	039090008
OPA2541	Substrate	MC01618-DMMT/A	MC01618-DMMT/A4
	Solder Flux	039090010	039090009
	Solder Paste	6036001	039090008

理由：Solder Flux/Paste供給業者製造終了及びSolder Attach Void低減の為

対象製品リスト

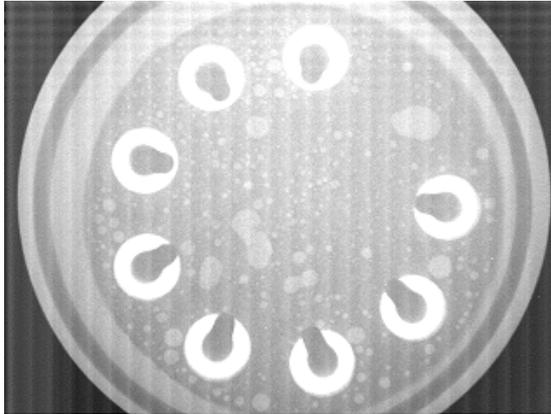
対象製品名			
OPA2541AM	OPA2541SM	OPA541AM	OPA541SM
OPA2541BM	OPA2541SMQ	OPA541BM	

詳細：

T03 Metal Can Substrate Backside MetalのSolder Flux, Solder Pasteを変更します。同時に、snowflakeパターンを使用するSubstrate backside metalの新規Substrateア트워크に変更します。これによりT03 Metal Canパッケージ製品のSubstrateからヘッダーへの接続を改善します。

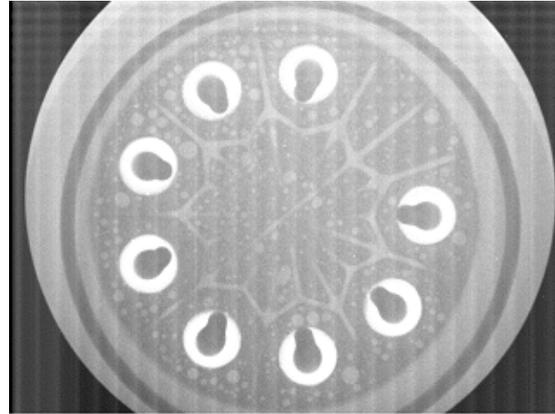
現行：

Standard Substrate: MC01616-DMMT/A



変更後：

Snowflake Substrate: MC01618-DMMT/A4



信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2012年9月5日	
信頼性試験 - 試料構成詳細					
Qual Device:	OPA2541SMQ	-	-		
Wafer Fab Site:	SFAB	Wafer Fab Process:	634G		
Standard Substrate:	MC01618-DMMT/A	Solder Flux:	039090009		
Package Code/Pins:	LMF/8	Solder Preform:	039090008		
信頼性試験結果					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails			
		Lot#1	Lot#2	Lot#3	
S1 Mechanical Shock	Note (1)	32/0	32/0	32/0	
S1 Vibration	Note (2)	32/0	32/0	32/0	
S1 Constant Acceleration	Note (3)	31/0	32/0	32/0	
S1 Fine and Gross leak	-	31/0	32/0	32/0	
S1 Electrical Test	Room temperature	31/0	31/0	32/0	
Temperature Cycle	-65C/150C, 500 Cycle	75/0	76/0	77/0	
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved	
X-ray	Inspect for solder attach	113/0	115/0	115/0	
Notes: Test Sequence S1 must follow the flow sequence shown below. (1) Condition B 1500 g, 0.5 ms Y1 6 pulses (2) Condition A 20g, 20-2000 hz All 3 planes (x, y, z) (3) Condition E 30 kg, Y1 only, 1 min					

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2012年9月17日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	OPA2541SMQ		-	-
Wafer Fab Site:	SFAB		Wafer Fab Process:	634G
Snowflake Substrate:	MC01618-DMMT/A4		Solder Flux:	039090009
Package Code/Pins:	LMF/8		Solder Preform:	039090008
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
S1 Mechanical Shock	Note (1)	32/0	32/0	32/0
S1 Vibration	Note (2)	32/0	32/0	32/0
S1 Constant Acceleration	Note (3)	32/0	32/0	32/0
S1 Fine and Gross leak	-	32/0	32/0	32/0
S1 Electrical Test	Room temperature	31/0	32/0	31/0
Temperature Cycle	-65C/150C, 500 Cycle	76/0	77/0	76/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
X-ray	Inspect for solder attach	125/0	125/0	125/0
Notes: Test Sequence S1 must follow the flow sequence shown below.				
(1) Condition B 1500 g, 0.5 ms Y1 6 pulses				
(2) Condition A 20 g 20-2000 hz All 3 planes (x, y, z)				
(3) Condition E 30 kg, Y1 only, 1 min				